

信頼性試験結果 Reliability Test

XC9306シリーズ

XC9306series

パッケージ : WLP-20-01
Package

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	100°C VIN=VDD=6.0V ※1 ※2	1000	0/76
2	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=VDD=6.0V ※1 ※2	1000	0/22
3	低温バイアス Low Temperature Bias	-55°C VIN=VDD=6.0V ※1 ※2	1000	0/22
4	高温放置 High Temperature Storage	150°C ※1 ※2	1000	0/22
5	プレッシャークッカーバイアス HAST	110°C85%RH 1.2×10 ⁵ Pa ※1 ※2	192	0/22
6	温度サイクル1 Temperature Cycle1	-65~150°C ※1 ※2	100cyc.	0/22
7	温度サイクル2 Temperature Cycle2	-25~125°C ※2 Daisy Chain Sample	1000cyc.	0/10
8	熱衝撃 Thermal Shock	0~100°C ※1 ※2	100cyc.	0/22
9	はんだ耐熱試験 Resistance to Soldering Heat	Pre Bake125°C/24h + 85°C/85%RH/168h + Reflow260°Cmax (3times) ※2 Moisture Sensitivity Level 1 (Based on IPC/JEDEC Std)		0/25
10	接合強度試験 Adhesive strength test	5um/s 10N以上 ※2 5um/s 10N over ※2		0/5
11	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 3mm 80mm/min 1回 Strain 3mm 80mm/min 1time		0/5
12	静電耐圧 Electric Static Discharge.	R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 R=0Ω C=200pF ±200V over 3times Each R=1500Ω C=100pF ±2kV以上 各端子3回 R=1500Ω C=100pF ±2kV over 3times Each		0/3
13	ラッチアップ Latch-Up	300mA以上 300mA over		0/4

※1) Pre-condition : Baking(125°C24h)→85°C/85%RH24h→Reflow(260°Cmax)→85°C/85%RH24h→Reflow(260°Cmax)
→85°C/85%RH24h→Reflow(260°Cmax)→85°C/85%RH24h→Reflow(260°Cmax)

※2) ウェハプロセス、パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable same wafer process & PKG type .